

广东利扬芯片测试股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的健康发展贡献积极力量。主要措施如下：

一、聚焦集成电路测试主业，持续提升核心竞争力

利扬芯片始终聚焦集成电路测试主业。公司现已成为国内知名的独立第三方专业测试技术服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片成品测试等主要生产环节；其中，晶圆测试和芯片成品测试是公司在集成电路产业链中所处的环节。

芯片测试在集成电路产业链中发挥着必不可少的作用，每颗芯片都需 100% 经过测试才能交付到市场终端。通过对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数的专业测试，才能够验证芯片是否符合设计的各项参数指标，确认在晶圆制造和芯片封装的过程中是否存在瑕疵。只有经测试合格的成品芯片才能应用于终端电子产品，真正体现出集成电路测试所扮演的守门员作用。根据芯片的实际应用领域、使用环境差异，以及终端应用对芯片品质的不同要求，公司会针对性的为客户开发不同测试深度、测试强度以及测试覆盖率的定制化 Turnkey 测试解决方案，以响应客户对集成电路测试的个性化性能需求和及时交付的需求。

公司测试的芯片产品应用于：（1）5G 通讯（PA、LNA、滤波器、Switch 等）；（2）传感器（MEMS、光感计、磁力计、气压计、温度计、加速度计、陀螺仪等）；（3）智能控制（物联网 AIoT、人脸识别、智慧家居等）；（4）汽车电子（BMS、ECU、车联网、智能座舱、TMPS、自动驾驶等）；（5）计算类芯片

(CPU、GPU、FPGA、ASIC、DSP、AI、服务器等); (6) 北斗应用 (短报文、雷达、导航、定位等); (7) 工业类和消费类产品 (医疗电子、电表应用、智能手机等); (8) 信息安全 (RSA 加密、ECC 加密、金融 IC 卡、加密算法、U-KEY 等)。

2024 年, 公司将继续坚持以市场为导向, 根据市场发展走势及公司战略布局方向, 积极储备中高端集成电路测试产能, 满足存量客户及潜在客户的测试产能需求, 聚焦主业发展, 持续提升核心竞争力。

二、研发积累与创新, 赋能竞争“核”动力

利扬芯片始终高度重视研发体系的建设。一方面, 公司始终坚持人才自主培养, 主要通过校园招聘方式储备及培养研发人员, 使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队; 另一方面, 结合不同应用领域的芯片测试技术开发需求, 科学搭建研发架构, 提高研发团队的协同性, 增强公司综合研发实力。因此, 公司的主要核心技术来源于自主研发, 在保证测试品质的情况下, 持续的研发投入使得测试解决方案在中高端芯片领域的广度及深度不断升级和积累, 进而提升测试效率, 具备自主开发和设计集成电路测试方案的能力, 以满足不同类型芯片的测试需求, 并运用于公司的主要产品中, 能够完成大规模批量测试, 保证测试的准确性和提升测试效率, 以满足市场需求及未来业务开展需要。

利扬芯片经过多年的自主测试技术方案开发及沉淀, 公司累计研发 44 大类芯片测试解决方案, 完成近 6, 000 种芯片型号的量产测试, 可适用于不同终端应用场景的测试需求, 以此积极协助客户制定解决方案并提供专业性的测试方案, 通过技术、品质、产能需求预判、交期等核心竞争力, 提高与客户战略合作的高度与紧密度, 并屡获客户认可取得多项独家测试。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产, 在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现, 为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司通过先进技术研究院对前沿芯片领域 (如 Chiplet、SIP、WLCSP 等先进封装芯片产品及传感器、存储、高算力、人工智能、大数据、北斗导航、CIS、车用芯片、无人驾驶等应用领域的芯片) 的测试技术研究, 拥抱科技浪潮, 把握行业未来发展的趋势, 保持对前瞻市场芯片测试需求的敏锐度和技术储备。

2024年，公司将持续投入研发创新，进一步夯实领先优势的测试技术，积极开发满足不同应用领域的芯片测试解决方案，重点布局工业控制、高算力（CPU、GPU、ISP等）、汽车电子、5G通讯、传感器（MEMS）、人工智能（AI）、存储（Nor/Nand Flash、DDR等）、智能物联网（AIoT）、无人驾驶等芯片的测试解决方案，并以此为方向进一步拓展市场，赋能竞争“核”动力，促进提升新质生产力，努力形成竞争新优势夯实基础。2024年，公司研发投入占营业收入的比例将维持一定水平，保持研发创新稳健投入。

三、优化财务管理，提升管理效能，提高资金使用效率

利扬芯片始终高度重视财务管理工作，将优化财务管理工作，财务中心深入各业务部门，深化业财融合理念，提高经营管理效能和资金使用效率。

1) **在生产与存货方面：**优化生产成本管理，优化生产质量管控，优化机物料使用效率，优化合理生产安排，充分提升产能利用率，减少冗余人力与低效管理人员，实现生产管理效益全面提升。

2) **在采购与付款方面：**优化采购管理，加强审核各环节单据，监察价格变动情况；持续深化供应链体系建设，优化供应链中的各个环节，系统推进采购降本、管理增效，实现供应链管理的全方位质量效益提升。

3) **在销售与收款方面：**优化销售管理、销售价格监督、核查；甄别客户资信情况，设立合理的信用政策，加强应收账款风险管理，建立多举措加快应收账款回收流程，提高应收账款周转率，加快资金周转，持续改善经营性现金流。

4) **资金规划方面：**利扬芯片将对自身财务资金管理体系进行优化升级，深入统筹、充分前瞻各子公司的融资计划和营运资金，利用财务数据进行分析和预测，合理规划资金使用，降低资金占用成本。

2024年，公司将以提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力，着力提高企业核心竞争力、增强核心功能，优化运营管理、提升经营质量效益，以应对市场变化和挑战，实现卓越的经营业绩，为股东创造更大价值。

四、注重股东回报，提升投资价值

利扬芯片始终高度注重股东回报，在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的同时重视股东回报，保持稳定、持续的利润分配政策，为投资者带来长

期、稳定的投资回报，增强投资者信心以及获得感。

利扬芯片自 2020 年在上海证券交易所科创板上市以后，积极分红回报全体股东。2020 年度的现金分红，派发现金红利合计 5,005.88 万元（含税），该年度公司现金分红金额占归属母公司股东的净利润比例为 96.36%；2021 年度的现金分红，派发现金红利合计 5,005.88 万元（含税），该年度公司现金分红金额占归属母公司股东的净利润比例为 47.30%。

2024 年 4 月 9 日，经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，利润分配预案如下：2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 20,012,122.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 92.13%。

未来，公司将结合经营现状和未来发展规划，坚持为投资者提供稳定的现金分红；我们致力于为股东带来长期的投资回报，积极构建可持续发展的股东回报机制，为公司的长期发展和股东的利益奠定坚实基础，进一步增强公司投资价值。

五、完善公司治理，推动高质量发展

利扬芯片始终高度重视内部治理。公司在已建立健全治理结构的同时，坚持规范治理，及时修订、更新相关制度，持续推进制度建设和内部控制体系建设，兼顾生产经营的同时，不断加强公司治理，推动公司生产经营业务稳健发展，进一步整合优化各项流程制度，提升组织能力与运营效率。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及其他相关法律法规的规定，严格按照相关管理制度执行，完善各项内部管理制度，持续强化信息披露及内部控制，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，保护投资者的合法权益，切实维护公司及股东的权益。

公司股东大会、董事会、监事会与管理层权责清晰、运行有效，明确主体“提质增效重回报”的责任担当，已形成体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

未来，公司将持续以赋予股东以及广大投资者长期价值为目标，不断优化健全法人治理结构和内部控制制度，加强股东大会、董事会及监事会管理体系的建设完善及执行，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司及全体股东利益，夯实公司可持续发展基础。

2024年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。

公司将建立监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析资本市场最新监管政策及法律法规，适时传递给主要股东、董事、管理层及相关业务部门。公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

六、构建多元沟通渠道，积极传递公司投资价值

利扬芯片始终高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将持续提升信息披露义务人的责任意识，积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

利扬芯片始终高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关的规章制度，持续优化与投资者的沟通工作，通过公司官网、投资者热线电话、邮箱、上证e互动、券商策略会、分析师会议、反路演、路演、网络会议、现

场参观、媒体采访、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

2024年，公司将在定期报告后安排业绩说明会，公司管理层与广大投资者进行沟通交流，实现公平、真诚、及时、准确的沟通。

公司将继续严谨、合规地开展信息披露和投资者关系管理工作。在此基础上，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，探索多元化沟通渠道，丰富宣传途径和交流形式。通过公司官网、公众号等媒介采用图文、视频等可视化方式对定期报告、临时公告进行解读，向广大投资者展示公司经营情况、财务状况、研发等情况，及时、公开、透明地传达给市场参与各方，使投资者全面了解公司，增强投资者对公司的信心和信任，建立长期稳定相互信赖的关系。

七、持续评估完善行动方案，塑造公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体实施，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，持续完善经营治理、提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司责任和义务，赢得投资者信任，塑造良好的市场形象。

本行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，所涉及的公司发展战略、发展规划等内容非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年4月9日